PHOTORESIST COMPOSITION

Patent Number:

JP2000122289

Publication date:

2000-04-28

Inventor(s):

URANO NAOYUKI; NARUSAKA MAKOTO; ONO HIROMICHI; TAKADA MAKI

Applicant(s)::

ASAHI GLASS CO LTD

Requested Patent:

JP2000122289 (JP00122289)

Application Number: JP19980294291 19981015

Priority Number(s):

IPC Classification:

G03F7/039; G03F7/004

EC Classification:

Equivalents:



RECEIVEL DEC 0 5 2001 TC 1700

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a photoresist compsn. which has good foaming property, excellent film forming property and storage stability without causing irregular coating or an uncoated region by icorporating a specified fluorine-contg. compd. into a photoresist source liquid. SOLUTION: This compsn. contains a photoresist source liquid and a fluorine- contg. compd. expressed by the formula of Rf-(CH2)aCH(CH3)O-(A1-O)k-R1. In the formula, Rf is a 1-22C polyfluoroalkyl group or 1-22C polyfluoroalkyl group having an ether type oxygen atom between the carbon-carbon bond, a is an integer 1 to 3. A1 is a >=2C alkylene group and when k is >=2, A1 may be two or more kinds, R1 is hydrogen atom, a 1-18C hydrocarbon group, acyl group or the like, and k is an integer 1 to 100. The obtd. photoresist compsn. has good foaming property, excellent film forming property and excellent storage stability without causing irregular coating or an uncoated region.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-122289 (P2000-122289A)

(43)公開日 平成12年4月28日(2000.4.28)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I			テーマコード(参考)
G03F	7/039	501	G03F	7/039	501	2H025
	7/004	501		7/004	501	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

(21)出願番号 特願平10-294291 (71)出願人 000000044 旭硝子株式会社 (22)出顧日 平成10年10月15日(1998.10.15) 東京都千代田区有楽 (72)発明者 占野 尚之 神奈川県横浜市神奈 旭硝子株式会社内 (72)発明者 鳴坂 良			
(22)出顧日 平成10年10月15日(1998. 10. 15) 東京都千代田区有楽 (72)発明者 占野 尚之 神奈川県横浜市神奈 旭硝子株式会社内			
(72)発明者 占野 尚之 神奈川県横浜市神奈 旭硝子株式会社内			
神奈川県横浜市神奈旭硝子株式会社内	町一丁目12番1号		
旭硝子株式会社内	占野 尚之		
旭硝子株式会社内	川区羽沢町1150番地		
(72) 登明者 临货 息			
東京都千代田区有楽	町1丁目12番1号 旭		
硝子株式会社内	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
(72)発明者 大野 裕通			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	内二丁目1番2号 旭		
	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-		
硝子株式会社内			
	最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 フォトレジスト組成物

(57)【要約】

【課題】塗布ムラがなく、消泡性が良く、塗れ残りが発生せず、成膜成に優れ、かつ、保存安定性にも優れたフォトレジスト膜を形成するフォトレジスト組成物を提供する。

【解決手段】フォトレジスト原液、および、 C_8 F $_{13}$ (CH_2) $_2$ CH (CH_3) O (CH_2 CH_2 O) $_3$ CH (CH_3) CH_2 C_8 F_{13} $\oplus OR^r - (CH_2)$ $\oplus CH$ (CH_3) $O-(A^1-O)_k-R^1$ で表される含フッ素化合物を含む。

【特許請求の範囲】

【請求項1】フォトレジスト原液、および、下式1で表 される含フッ素化合物を含むことを特徴とするフォトレ*

ł

ただし、式中の記号は以下の意味を示す。

Rf1: 炭素数1~22のポリフルオロアルキル基、また は、炭素-炭素結合間にエーテル性酸素原子が挿入され た炭素数1~22のポリフルオロアルキル基。

a:1~3の整数。

 A^1 : 炭素数2以上のアルキレン基であり、kが2以上 10 の場合のA1 は2種以上であってもよい。

R1:水素原子、炭素数1~18の炭化水素基、炭素数 1~18のアシル基、または-CH(CH₃)(CH 2)_b-R^{f2} (ただし、bは1~3の整数、R^{f2}は炭素 数1~22のポリフルオロアルキル基、または、炭素ー 炭素結合間にエーテル性酸素原子が挿入された炭素数1 ~22のポリフルオロアルキル基。)。

k:1~100の整数。

【請求項2】R「が、炭素数4~12のペルフルオロア ルキル基、または、炭素-炭素結合間にエーテル性酸素 20 原子が挿入された炭素数4~12のペルフルオロアルキ ル基である請求項1に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項3】kが2以上である場合のA¹が、エチレン 基のみ、テトラエチレン基のみ、またはエチレン基とプ ロピレン基からなる請求項1、2、または3に記載のフ ォトレジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特定の含フッ素化 合物を含むフォトレジスト組成物に関するものである。 詳しくは塗布ムラがなく、消泡性が良く、塗れ残りが発 生せず、成膜成に優れ、かつ、保存安定性にも優れたフ ォトレジスト膜を形成するフォトレジスト組成物に関す る。

[0002]

【従来の技術】集積回路は年を追うごとに高集積化さ れ、ダイナミックランダムアクセスメモリー(DRA M)を例にとれば、現在では、4Mビットの記憶容量を 持つものの本格生産が開始されている。それに伴い集積 回路の生産に不可欠のフォトリソグラフィー技術に対す 40 る要求も年々厳しくなってきており、たとえば、1 Mビ ットDRAMの生産には、1μmレベルのリソグラフィ ー技術が必要とされ、4M、16MのDRAMにおいて は、それぞれ、 $0.8\mu m$ 、 $0.5\mu m$ レベルのリソグ ラフィー技術が必要とされている。

【0003】上記の様な極微細加工を高精度で達成する ため、フォトリソグラフィー技術においては、レジスト 組成物が解像度や感度といった転写特性に優れているば かりでなく、その形成された塗布膜が塗布ムラ等がなく※ *ジスト組成物。

【化1】

 R^{f} - (CH_{2}) a CH (CH_{3}) O- (A^{1} - O) k - R^{1} · · · 式1

※膜厚が髙精度に均一であることが要求される。この均一 性が充分でないと、塗布膜厚に応じて形成されたレジス トパターンの寸法が変化し、半導体の製造に必要なパタ ーン精度が得られない問題が発生する。

【0004】従来、塗布膜の膜厚の均一性を向上するの を目的として、たとえば特開昭62-36657号公報 に記載されるフッ素系界面活性剤を添加したフォトレジ スト組成物が知られている。しかし、該組成物において は、レジスト液の調製中またはレジスト液の供給段階で レジスト液中に発生した気泡が消えにくく、レジスト液 を供給するラインに装着されたフィルタ部分に泡が溜ま って安定した量のレジスト液のウエハへの滴下が行えな くなったり、滴下されたレジスト液中に極微小な気泡が 混入して塗布ムラが発生し髙精度な塗布膜が得られない 等の問題があった。また、従来のレジスト液は、保存安 定性が不充分である問題があった。

【0005】一方、消泡性は、フォトレジストの生産性 の面からも重要視されてきている。通常、フォトレジス トはビンにノズルを通して充填されるが、泡立ちが激し いとビンからあふれてしまい充填が困難である。したが って、従来の泡立ち易い性質を有するフォトレジストの 場合は、泡が立たないように充填スピードを大幅に落と さなければならない。

【0006】さらに、ここ数年、ウエハがさらに大口径 化していることに伴い、従来のレジスト組成物ではウエ 30 ハ端面に濡れ残りが発生しやすいという問題も起こって いる。したがって、形成される塗布膜に塗布ムラが発生 せず、消泡性が良く、塗れ残りが発生しにくいフォトレ ジスト組成物が要望されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、塗布 ムラがなく、消泡性が良く、塗れ残りが発生せず、成膜 成に優れ、かつ、保存安定性にも優れたフォトレジスト 組成物を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者等は上述のよう な問題点を解決するために種々検討を重ねた結果、特定 の含フッ素化合物を、フォトレジスト原液中に含有させ ることにより、上記目的を達成しうることを見出し、本 発明を完成するに至った。

【0009】すなわち、本発明は、フォトレジスト原 液、および、下式1で表される含フッ素化合物を含むこ とを特徴とするフォトレジスト組成物を提供する。

[0010]

【化2】

 $R^r - (CH_2)_{\kappa} CH (CH_3) O - (A^1 - O)_{\kappa} - R^1 \cdot \cdot \cdot \cdot$ 式1

【0011】ただし、式中の記号は以下の意味を示す。 R*1: 炭素数1~22のポリフルオロアルキル基、また は、炭素-炭素結合間にエーテル性酸素原子が挿入され た炭素数1~22のポリフルオロアルキル基。

a:1~3の整数。

A1: 炭素数2以上のアルキレン基であり、kが2以上 の場合のA1は2種以上であってもよい。

R1:水素原子、炭素数1~18の炭化水素基、炭素数 1~18のアシル基、または-CH(CH₃)(CH $_2$) $_b$ $-R^{r2}$ (ただし、bは1~3の整数、 R^{r2} は炭素 10 数1~22のポリフルオロアルキル基、または、炭素-炭素結合間にエーテル性酸素原子が挿入された炭素数1 ~22のポリフルオロアルキル基。)。k:1~100 の整数。

[0012]

【発明の実施の形態】以下において式1で表される含フ ッ素化合物を「特定の含フッ素化合物」という。本発明 のフォトレジスト組成物は、フォトレジスト原液中に、 特定の含フッ素化合物を含む。フォトレジスト原液とし ては、特に限定されず、ポジ型、ネガ型のいずれのフォ 20 トレジスト原液であっても採用できる。フォトレジスト 原液としては、光感受性化合物、樹脂、および有機溶剤 を必須成分とするものが好ましく、特に以下のフォトレ ジスト原液 (PR-1)、フォトレジスト原液 (PR-2)、またはフォトレジスト原液(PR-3)が好まし

【0013】フォトレジスト原液(PR-1):キノン ジアジド系感光性化合物およびアルカリ可溶性樹脂を有 機溶媒に溶解してなるフォトレジスト原液。フォトレジ スト原液(PR-2):光酸発生剤、架橋剤およびアル 30 カリ可溶性樹脂を有機溶媒に溶解してなるフォトレジス ト原液。フォトレジスト原液(PR-3):光酸発生 剤、アルカリ可溶性樹脂および必要に応じて溶解抑止剤 を有機溶媒に溶解してなるフォトレジスト原液。

【0014】以下、PR-1~PR-3について説明す

[PR-1について] PR-1におけるアルカリ可溶性 樹脂としては、従来より公知の種々のアルカリ可溶性樹 脂が使用できる。具体的には、ノボラック樹脂、ポリヒ ドロキシスチレンまたはその誘導体、スチレンー無水マ 40 レイン酸共重合体等が挙げられ、好ましくはノボラック 樹脂、ポリヒドロキシスチレンまたはその誘導体が挙げ られ、とりわけノボラック樹脂が好ましい。

【0015】ノボラック樹脂としては、フェノール、o ークレゾール、mークレゾール、pークレゾール、3ー エチルフェノール、2,5-キシレノール、3,5-キ シレノール等のアルキルフェノール類、2-メトキシフ ェノール、4ーメトキシフェノール、4ーフェノキシフ ェノール等のアルコキシまたはアリールオキシフェノー ル類、α-ナフトール、β-ナフトール、3-メチルー 50 が挙げられる。オルトキノンジアジド基を含む化合物と

 α ーナフトール等のナフトール類や、1, 3ージヒドロ キシベンゼン、1, 3-ジヒドロキシー2-メチルベン ゼン、1, 2, 3-トリヒドロキシベンゼン、1, 2, 3 -トリヒドロキシ-5 -メチルベンゼン、1, 3, 5ートリヒドロキシベンゼン等のポリヒドロキシベンゼン 類等のヒドロキシ芳香族化合物と、ホルムアルデヒド、 パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、パラアルデ ヒド等の脂肪族アルデヒド類、ベンズアルデヒド等の芳 香族アルデヒド類、アセトン等のアルキルケトン類等の カルボニル化合物とを、たとえば塩酸、硫酸、しゅう酸 等を触媒として、混合加熱し重縮合させ製造された樹脂 が好ましい。これらのうち、ヒドロキシ芳香族化合物と して、アルキルフェノール類の1種以上を用いて、これ とカルボニル化合物の重縮合で得られるノボラック樹脂 が好ましい。

【0016】さらに好ましく用いられるノボラック樹脂 は、m-クレゾール、p-クレゾール、2,5-キシレ ノールおよび3,5ーキシレノールのうちの1種以上 と、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、パラアルデ ヒドのいずれか1種以上とを、塩酸、しゅう酸等を触媒 として、混合加熱し重縮合して製造されたものが挙げら

【0017】特に好ましくは、m-クレゾール、p-ク レゾールおよび2.5-キシレノールを、ホルムアルデ ヒド単独またはホルムアルデヒドおよびアセトアルデヒ ドもしくはパラアルデヒドとを塩酸、しゅう酸等を触媒 として、混合加熱し重縮合して製造されたものが挙げら れ、これらとの組み合わせにおいて特に解像力の向上が 顕著である。上述のノボラック樹脂のポリスチレン換算 重量平均分子量(以下、単に分子量という)としては、 30000以下が好ましく、特に好ましくは20000 以下であり、一方、2500以上が好ましく、特に好ま しくは3000以上である。分子量が低すぎるとフォト レジスト組成物の耐熱性の劣化が著しく、また高すぎる と感度の劣化が著しくなる傾向があるので、集積回路の 安定製造には好ましくない場合がある。

【0018】ポリヒドロキシスチレンまたはその誘導体 としては、4-ヒドロキシスチレン、3-メチル-4-ヒドロキシスチレン、3-クロロ-4-ヒドロキシスチ レン等のヒドロキシスチレン誘導体を公知の方法に準じ て重合させ製造することができる。なお、上述のアルカ リ可溶性樹脂は、必要に応じ、さらに、水素等により選 元し短波長領域の吸光を低くしたものを用いてもよい。 また、上述のアルカリ可溶性樹脂を製造するための原料 である芳香族化合物モノマーは、要求性能に悪影響を与 えない限りハロゲン原子、ニトロ基、エステル基等の置 換基を有していてもよい。

【0019】PR-1におけるキノンジアジド系感光性 化合物としては、オルトキノンジアジド基を含む化合物

しては、オルトキノンジアジド基をその構造中に含む種 々の化合物を含みうるが、具体的には1.2-ベンゾキ ノンジアジドー4ースルホン酸、1.2ーナフトキノン ジアジドー4-スルホン酸、1,2-ナフトキノンジア ジドー5ースルホン酸等のエステルまたはアミド等が好 適である。さらに具体的にはグリセリン、ペンタエリス リトール等のポリヒドロキシアルキル化合物、前記アル カリ可溶性樹脂の記載において例示したヒドロキシ芳香 族化合物とカルボニル化合物の重縮合物であるノボラッ ク樹脂、ビスフェノールA、没食子酸エステル、ケルセ 10 チン、モリン、ポリヒドロキシベンゾフェノン等のポリ ヒドロキシ芳香族化合物の1, 2-ベンゾキノンジアジ ドー4ースルホン酸エステル、1,2ーナフトキノンジ アジドー4-スルホン酸エステル、1,2-ナフトキノ ンジアジドー5ースルホン酸エステルまたはそれらのア ミド等が用いられる。

【0020】なお、ポリヒドロキシベンゾフェノンとし てば、2、3、4-トリヒドロキシベンゾフェノン、 2, 3, 4, 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、 2, 3, 4, 2', 4'-ペンタヒドロキシベンゾフェ 20 ノン、2、3、4、3′、4′、5′ーヘキサヒドロキ シベンゾフェノン等のトリ~ヘキサヒドロキシベンゾフ ェノン等が挙げられる。また、1,2-キノンジアジド 基を含む化合物としては、たとえば特開平2-2693 51や特開平3-48249に記載されるフェノール性 水酸基を持った化合物のナフトキノンジアジドスルホン 酸エステルも好ましく用いることができる。

【0021】これらの1、2-キノンジアジド基を含む 化合物は、単独で用いても、2種以上を混合して用いて もよい。これらのうち、分子型が600~2200程度 30 のノボラック樹脂またはポリヒドロキシベンゾフェノン の1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エス テルが好ましく用いられる。特に好ましく用いられる 1, 2-キノンジアジド化合物としては、m-クレゾー ルとホルムアルデヒドおよびアセトアルデヒドのいずれ か単独または両方とを重縮合して製造されたノボラック 樹脂や、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン、 2. 3. 4. 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、 2. 3, 4, 2', 4' -ペンタヒドロキシベンゾフェ ノンの1.2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸 40 エステルが挙げられる。これらの感光性化合物の水酸基 のエステル化による置換率の好適な範囲は感光性化合物 の種類により様々であるが、上記ノボラック樹脂のエス テル化物については25~70%が好ましく、ポリヒド ロキシベンゾフェノンのエステル化物については50~ 95%が好ましい。この置換率が低すぎると、フォトレ ジスト組成物の解像力が劣化する傾向があり、また高す ぎると、感度の低下が著しくなる傾向がある。

[0022] [PR-2cont] PR-2cthar ルカリ可溶性樹脂としては、フォトレジスト組成物(P = 50 - R - 1)および(PR - 2)において例示したと同様の

R-1)において例示したものと同様のものが挙げら れ、ポリヒドロキシスチレンまたはその誘導体が好まし く、ポリヒドロキシスチレン誘導体としては、ヒドロキ シスチレンと、これ以外の他のモノマー類を共重合成分 として含有する共重合ポリマーが挙げられる。

【0023】共重合成分である他のモノマーとしては、 アクリル酸、アクリル酸エチル、メタクリル酸、メタク リル酸メチル、クロトン酸、クロトン酸エチル、桂皮 酸、桂皮酸エチル等のアクリル酸誘導体、スチレン、ス チルベン、ビニルシクロヘキサン等のスチレン誘導体、 マレイン酸、マレイン酸ジメチル、メチルマレイン酸、 メチルマレイン酸ジメチル等のマレイン酸誘導体、メチ ルピニルケトン等のピニルケトン類、メチルピニルエー テル等のビニルエーテル類が挙げられる。ポリヒドロキ シスチレンおよびその誘導体の分子量は、通常1000 ~20000程度、好ましくは2000~10000程 度である。

【0024】PR-2における光酸発生剤としては、ポ リハロゲン化炭化水素基を含む化合物、具体的にはヘキ サクロロエタン、ヘキサクロロアセトン、1, 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサクロロシクロヘキサノン、四臭化炭 素、ヨードフォルム、1,1,2,2-テトラブロモエ タン、1、2、3、4ーテトラブロモブタン等のポリハ ロゲン化炭化水素基を含む炭化水素類が挙げられる。ま た、これらのポリハロゲン化炭化水素基は、たとえば、 トリス (トリクロロメチル) -s-トリアジン、ビス (トリプロモメチル) ベンゼン、トリプロモメチルフェ ニルスルホン等のように、トリアジン、ベンゼン等の置 換基として、またはスルフォン化合物の構成基として含 有されていてもよい。また、ジフェニルヨードニウムへ キサフルオロホスフェート、ジフェニルヨードニウムク ロライド等のジアリルヨードニウム塩、トリフェニルス ルホニウムヘキサフルオロホスフェート、トリフェニル スルホニウムプロマイド、ニトロベンジルトシレート等 のトリアリール、スルホニウム塩等のオニウム塩をポリ ハロゲン化炭化水素基を持つ化合物として用いることも

【0025】PR-2における架橋剤としては、たとえ ばヘキサメトキシメチル化メラミン等のアルコキシメチ ル化メラミン、N, N, N', N'ーテトラヒドロキシ メチルサクシナミド等のアルコキシメチル化サクシナミ ド、N、N、ージメトキシメチル尿素、テトラメトキシ メチル尿素等のアルコキシメチル化尿素、2、4、6-トリヒドロキシメチル化フェノール等の、ヒドロキシメ チル基、メトキシメチル基、またはエトキシメチル基等 の架橋性基を1分子中に2個以上含有する化合物等が挙 げられる。

[0026][PR-3kn]PR-3knルカリ可溶性樹脂としては、フォトレジスト組成物(P

ものが挙げられるが、かかるアルカリ可溶性樹脂は、ア ルカリ可溶性を与える官能基の一部がtーブトキシカル ボニル基、t-アミルオキシカルボニル基、t-ブチル 基、t-アミン基、t-ヘキシル基、アリル基、等の酸 に対して不安定な基で置換されていてもよい。

【0027】PR-3における光酸発生剤としては、上 記フォトレジスト組成物(PR-2)において例示した ものと同様のものが挙げられる。また、溶解抑止剤とし ては、ビスフェノールーA、ビスフェノールーS、ビフ ェノール、カテコール、フロログリシノール、ピロガロ 10 ール等のフェノール化合物の水酸基をt-ブトキシカル ボニル基等で保護したものが挙げられる。

【0028】フォトレジスト原液(PR-1~3)中に 含まれる有機溶媒としては、たとえば乳酸メチル、乳酸 エチル、グリコール酸エチル等のグリコール酸エステル 誘導体類、エチルセロソルブアセテート、メチルセロソ ルブアセテート、プロピレングリコールモノメチルエー テルアセテート等のグリコールエーテルエステル誘導体 類、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル等のケトンエ ステル類、3-メトキシープロピオン酸メチル、3-エ 20 トキシプロピオン酸エチル等のアルコキシカルボン酸エ ステル類、アセチルアセトン、シクロペンタノン、シク ロヘキサノン、2-ヘプタノン等のケトン誘導体類、ジ アセトンアルコールメチルエーテル等のケトンエーテル 誘導体類、アセトール、ジアセトンアルコール等のケト ンアルコール誘導体類、ジメチルアセトアミド、ジメチ ルホルムアミド等のアミド誘導体類、アニソール、ジエ チレングリコールジメチルエーテル等のエーテル誘導体 類等が挙げられる。また、必要に応じてキシレン、酢酸 ブチル等を添加した混合溶媒を用いることもできる。

【0029】これらのうち、保存安定性、膜の均一性、 安全性、取扱いの容易さ等を勘案すると3-メトキシプ ロピオン酸メチル、乳酸メチルまたは乳酸エチルを主成 分として含む混合溶媒が好ましく用いられ、特に好まし くは3-メトキシプロピオン酸メチルまたは乳酸エチル とプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート または酢酸ブチルとの混合溶媒が用いられる。

【0030】フォトレジスト原液(PR-1)における アルカリ可溶性樹脂の濃度は、通常1~40重量%程度 である。また、キノンジアジド系感光性化合物の濃度 は、通常1~30重量%程度である。また、フォトレジ スト原液中の固型分に対するキノンジアジド系感光性化 合物の割合は、通常20~60重量%程度である。

【0031】フォトレジスト原液(PR-2)および (PR-3) におけるアルカリ可溶性樹脂の濃度は、通 常10~40重量%程度であり、光酸発生剤の濃度は通 常0.1~10重量%程度であり、さらに、フォトレジ スト組成物中の固型分に対する光酸発生剤の割合は、通 常1~10重量%程度である。また、架橋剤の含有量 は、アルカリ可溶性樹脂に対し0.01~0.5重量倍 50 g Fip- [たとえばF(CF2)g -]、CioF2i-

程度であり、溶解抑制剤を含有する場合、その含有量 は、アルカリ可溶性樹脂に対し0.1~1重量倍程度で ある。さらに、本発明のホトレジスト原液中には基板よ りの乱反射光の影響を少なくするために吸光性材料を、 また、感度向上のための増感剤等をさらに添加すること もできる。

【0032】本発明の最大の特徴は、フォトレジスト組 成物中に特定の含フッ素化合物を含ませることにある。 これにより、優れた消泡性、塗布ムラ防止性、塗れ残り 発生を防止し、組成物の保存安定性を向上させる等の優 れた効果が発揮されうる。

【0033】以下、特定の含フッ素化合物について説明 する。本明細書においては、ポリフルオロアルキル基を R「基とも記載する。R「基は、アルキル基の水素原子 の2個以上がフッ素原子に置換された基をいう。R「基 の炭素数は2~20が好ましく、特に6~16が好まし い。また、R「基は、直鎖状または分岐状の基が好まし く、特に直鎖状の基が好ましい。分岐状の基である場合 には、分岐部分がR「基の末端部分に存在し、かつ、炭 素数1~4程度の短鎖であるのが好ましい。

【0034】R「基は、フッ素原子以外の他のハロゲン 原子を含んでいてもよい。他のハロゲン原子としては、 塩素原子が好ましい。R「基の末端部分の構造として $t \cdot -CF_2 \cdot CF_3 \cdot -CF \cdot (CF_3)_2 \cdot -CF_2$ H、-CFH2、-CF2C1等が挙げられ、-CF2 CF3 が好ましい。また、Rf 基の結合末端の炭素原子 には1個以上のフッ素原子が結合しているのが好まし

【0035】R「基中のフッ素原子の数は、[(R「基 30 中のフッ素原子数)/(R 基と同一炭素数の対応する アルキル基中に含まれる水素原子数)]×100(%) で表現した場合に、60%以上が好ましく、特に80% 以上が好ましい。さらにRf基は、アルキル基の水素原 子の全てがフッ素原子に置換された基であるペルフルオ ロアルキル基、またはペルフルオロアルキル基を末端部 分に有する基が好ましい。

【0036】ペルフルオロアルキル基の炭素数は、1~ 22が好ましく、特に4~12が好ましい。炭素数が4 未満の場合には、性能が不充分になるおそれがあり、1 2 超の場合には、取扱いが困難になるおそれがあるから

【0037】R「基の具体例としては、以下の基が挙げ られる。

 $C_4 F_9 - [F (CF_2)_4 -, (CF_3)_2 CFCF]$ 2 -、 (CF3)3 C-、およびCF3 CF2 (CF a) CF-等の構造異性の基を含む]、C_δ F₁₁-[た とえばF (CF_2) $_5$ -]、 C_6 F_{13} - [たとえばF $(CF_2)_{6}$ -]、 C_7 F_{15} - [たとえばF (CF_2) 7 -]、C₈ F₁₇- [たとえばF (CF₂)₈ -]、C

30

 $[\text{ck} \lambda \text{dF} (\text{CF}_2)_{10} -] \cdot \text{C}_{12} \text{F}_{25} - [\text{ck} \lambda \text{d}]$ $F(CF_2)_{12}-$]、 $C_{14}F_{29}-$ [たとえば $F(CF_2)_{12}$] 2) 14-]、C16F33-[たとえばF(CF2) $_{18}$ -], CClF₂ (CF₂)_s - (22 $^{\circ}$, stl-21の整数)、CF₂ H (CF₂)_t - (ここで、tは 1~21の整数)、(CF₃)₂ CF(CF₂)_y -(ここで、yは1~19の整数)等。

【0038】また、炭素-炭素結合間にエーテル性酸素 原子が挿入されたR^r基としては、以下の基が挙げられ る。

 CF_3 (CF_2) 4 OCF (CF_3) -, F [CF (C F_3) CF_2 $O]_r$ CF (CF_3) CF_2 CF_2 -, F $[CF(CF_3)CF_2O]_zCF(CF_3) [CF(CF_3)CF_2O]_uCF_2CF_2-,F(C$ $F_2 CF_2 CF_2O) \lor CF_2 CF_2 - \lor F (CF_2 CF_2)$ F_2 O) $_{\star}$ CF $_2$ CF $_2$ - $_{\star}$ (r, zt1 \sim 100 \otimes 数、uは2~6の整数、vは1~11の整数、wは1~ 11の整数) 等。

【0039】特定の含フッ素化合物におけるR宀は、炭 素数1~22のポリフルオロアルキル基、または、炭素 20 - 炭素結合間にエーテル性酸素原子が挿入された炭素数 1~22のポリフルオロアルキル基を示す。R*1は、炭 素数1~22のペルフルオロアルキル基、または、炭素 一炭素結合間にエーテル性酸素原子が挿入された炭素数 1~22のペルフルオロアルキル基が好ましく、特に炭 素数4~12のペルフルオロアルキル基、または、炭素 - 炭素結合間にエーテル性酸素原子が挿入された炭素数 4~12のペルフルオロアルキル基が好ましい。さら に、Rflは、炭素数4~12のペルフルオロアルキル基 が好ましい。

【0040】aは1~3の整数であり、2または3が好 ましい。A1は炭素数2以上のアルキレン基であり、k が2以上の場合のA'は2種以上であってもよい。A' は、炭素数2、3、または4のアルキレン基が好まし く、エチレン基、プロピレン基、トリメチレン基、また はテトラメチレン基が好ましい。 kが2以上の場合のA ¹ は1種または2種からなるのが好ましく、特にエチレ ン基のみからなる、またはエチレン基とプロピレン基か らなるのが好ましい。A¹ が2種以上存在する場合であ って(A¹-O)部分が3以上存在する場合は、各(A 40 ¹ -O) 部分はブロック状に連なっていても、ランダム 状に連なっていてもよい。

【0041】kは2~100であるのが好ましく、特に 3~50が好ましい。また、特定の含フッ素化合物はk の値の異なる2種以上の化合物からなるのが好ましい。 kが2種以上である場合、特定の含フッ素化合物の k は、kの平均値をkaとした場合、1~3kaの範囲に 分布しているの性能および安定性の点で好ましい。

【0042】R¹は、水素原子、炭素数1~18の炭化 水素基、炭素数1~18のアシル基、または-CH(C 50 ックである場合には、R宀-(CH₂)aCH(CH

 H_3) (CH_2) $_{b}$ $-R^{r_2}$ (ただし、 $bは1\sim3$ の整 数、R^{f2}は炭素数1~22のポリフルオロアルキル基、 または、炭素-炭素結合間にエーテル性酸素原子が挿入 された炭素数1~22のポリフルオロアルキル基を示 す。)を示す。

【0043】R1 が炭素数1~18の炭化水素基である 場合には、炭素数1~5の炭化水素基が好ましく、炭素 数1~5のアルキル基がより好ましく、CHョー、CH g CH₂ - 、直鎖状または分岐状のCg H₂ - 、直鎖状 10 または分岐状のC4 He -、または直鎖状または分岐状 の $C_6 H_{11}$ -が挙げられる。また、 R^1 が炭素数 $1\sim 1$ 8のアシル基である場合、該アシル基としては、炭素数 1~10のアシル基が好ましく、特に炭素数1~6のア シル基が好ましい。アシル基である場合の特定の含フッ 素化合物は、分子末端にエステル結合を含む構造であ り、該構造の場合には起泡性が抑制される。

【0044】さらに、該アシル基をR10CO-で表す場 合、R¹⁰部分が、炭素数1~17のアルキル基またはア ルケニル基である場合が好ましい。

アシル基(R10CO-)の具体例としては、CH3 CO -, CH₃ CH₂ CO-, CH₃ (CH₂)₂ CO-, CH_3 (CH_2) 3 CH (CH_2 CH_3) CO-, CH $_3$ (CH₂) $_7$ CH=CH (CH₂) $_7$ CO- $_5$ state CH₃ (CH₂)₁₆CO-等の基が挙げられる。

 $[0045]R^{1} M-CH (CH_{3}) (CH_{2})_{b}-R$ f2である場合、bは2または3であるのが好ましく、a と同一値であるのが好ましい。また、Rf2は炭素数1~ 22のポリフルオロアルキル基であり、Rf1と同様の基 が好ましい。式1中にRflおよびRf2が存在する場合、 これらは同一であっても異なっていてもよいが、同一で あるのが好ましい。これらのうち、R1としては、水素 原子、メチル基、または-CH(CH₃)(CH₂)_b -R^{r2}が好ましい。

【0046】特定の含フッ素化合物は、Rf 基と(A1 -O) との間に、- (CH2) a CH (CH3) O-な る基を必須とする。また、場合によっては一〇CH(C H₃) (CH₂)_b - なる基を必須とする。該基は、フ ォトレジスト組成物の泡立ちや空気の巻き込みを防ぎ、 かつ化合物の化学的安定性にも寄与する重要な基であ る。また、本発明の特定の含フッ素化合物は、末端の構 造として、-COOH等の酸性基やカチオン性基等を有 しない化合物であることから、フォトレジスト原液に含 まれる成分に作用して沈殿を生成させいない優れた化合 物である。

【0047】本発明における特定の含フッ素化合物(式 1) としては、式(1A) または下式(1B) で表され る化合物が好ましい。なお、式(1B)におけるオキシ エチレン基とオキシプロピレン基の連なり方は、ブロッ クであってもランダムであってもよい。連なり方がブロ

11

3) 〇一にポリオキシプロピレン基が連結し、該ポリオ キシプロピレン基にポリオキシエチレン基が連結する場 合が好ましい。ただし、式(1A)、(1B)における R^f 、 R^1 は、式1における意味と同じ意味を示し、好 ましい態様も同じである。

【0048】式(1A)におけるmは1~100の整数 を示し、1~50が好ましく、特に3~30が好まし い。式(1B) におけるnは1~100の整数、pは0* *****~100の整数を示し、1≦n+p≦100である。さ らに、nは1~30の整数が好ましく、pは0~20の 整数が好ましく、1≤n+p≤30であるのが好まし い。さらに、 $0.2 \le n / (n+p) \le 1$ が好ましく、 0. $5 \le n / (n+p) \le 1$ がより好ましく、0. $7 \le$ n/(n+p) ≤1が特に好ましい。

12

[0049]

【化3】

 R^{fi} - $(CH_2)_a CH (CH_3) O (CH_2 CH_2 O)_n R^1$

···式(1A)

 $R^{f1}-(CH_2)_aCH(CH_3)O-$

- [CH (CH₃) CH₂ O], (CH₂ CH₂ O), R¹···式 (1B)

20

【0050】特定の含フッ素化合物(式1)の具体例と しては、下記化合物が挙げられるがこれらに限定されな い。ただし、下記式において、パーフルオロアルキル基 に該当する部分は直鎖状であっても分岐状であってもよ く、直鎖状であることが好ましい。また、2種以上のオ キシアルキレン部分が存在する場合には、それらの連な り方はブロックであってもランダムであってもよい。な お、(Ca Ho O)部分は、オキシプロピレン基である ことを示し、 [CH (CH₃) CH₂ O] または [CH 2 CH(CH₃)O]であることを示す。

[0051]

[$(\text{CH}_2)_{13}(\text{CH}_2)_{2}(\text{CH}_3)_{0}(\text{CH}_2\text{CH}_2)_{5}$ H, $(\text{C}_6\text{F}_{13}(\text{CH}_2)_{13})_{13}(\text{CH}_2)_$ 2CH(CH₃)0(CH₂CH₂O)₈H, C₇F₁₅(CH₂)₂CH(CH₃)0(CH₂CH₂O) $_{5}$ Н, $C_{8}F_{17}(CH_{2})_{2}$ СН $(CH_{3})_{0}(CH_{2}CH_{2}O)_{5}$ Н, $C_{8}F_{17}(CH_{2})_{2}$ СН $(CH_3)0(CH_2CH_20)_{10}H$, $C_6F_{13}(CH_2)_2CH(CH_3)0(C_3H_60)_5(C_3H_60)_5$ $H_2CH_2O)_{10}H$, $C_7F_{16}(CH_2)_2CH(CH_3)O(C_3H_6O)_5(CH_2CH_2O)$ $_{10}\mbox{H}$, $C_{8}\mbox{F}_{17}(\mbox{CH}_{2})_{2}\mbox{CH}(\mbox{CH}_{3})\,0\,(\mbox{C}_{3}\mbox{H}_{6}\mbox{O})_{5}\,(\mbox{CH}_{2}\mbox{CH}_{2}\mbox{O})_{10}\mbox{H}$, C_{6} $F_{13}(CH_2)_2CH(CH_3)O(C_3H_6O)_4(CH_2CH_2O)_{15}H_1, C_7F_{15}(CH_2)$ $_{2}$ CH(CH₃)0(C₃H₆0)₄(CH₂CH₂0)₁₅H , C₈F₁₇(CH₂)₂CH(CH₃) $0(C_3H_60)_4(CH_2CH_20)_{15}H$, $C_6F_{13}(CH_2)_2CH(CH_3)_0(CH_2CH_2)_15H$ CH₂CH₂O)₅H, C₆F₁₃(CH₂)₂CH(CH₃)O(CH₂CH₂CH₂CH₂O)₈H, C₇F₁₅(CH₂)₂CH(CH₃)0(CH₂CH₂CH₂CH₂O)₅H, C₈F₁₇(CH₂)₂C $H(CH_3)O(CH_2CH_2CH_2CH_2O)_5H$, $C_8F_{17}(CH_2)_2CH(CH_3)O(CH_2C)_6H$ $H_2CH_2CH_2O)_{10}H$, $C_8F_{17}(CH_2)_2CH(CH_3)O(CH_2CH_2CH_2CH_2O)$ 20H , CoF13(CH2)2CH(CH3)0(CH2CH2O)6CH3, CoF13(CH2) 2CH(CH₃)0(CH₂CH₂0)₈C₂H₅ , C₇F₁₅(CH₂)₂CH(CH₃)0(CH₂C $H_2O)_5COCH_3$, $C_8F_{17}(CH_2)_2CH(CH_3)O(CH_2CH_2O)_5COCH_3$, C_8 $F_{17}(CH_2)_2CH(CH_3)O(CH_2CH_2O)_{10}COCH_3, C_6F_{13}(CH_2)_2CH(CH_4O)_{10}COCH_3$ $_{3})0(CH_{2}CH_{2}O)_{5}CH(CH_{3})(CH_{2})_{2}C_{6}F_{13}$, $C_{6}F_{13}(CH_{2})_{2}CH(CH_{3})$ $_{3})0(CH_{2}CH_{2}O)_{8}CH(CH_{3})(CH_{2})_{2}C_{6}F_{13}$, $C_{7}F_{15}(CH_{2})_{2}CH(CH_{3})$ $_{3}$) O (CH₂CH₂O) $_{5}$ CH (CH₃) (CH₂) $_{2}$ C $_{7}$ F₁₅ , C₈F₁₇ (CH₂) $_{2}$ CH (CH $_{3})0(CH_{2}CH_{2}O)_{5}CH(CH_{3})(CH_{2})_{2}C_{8}F_{17}$, $C_{8}F_{17}(CH_{2})_{2}CH(CH_{3})$ $_{3}$) 0 (CH₂CH₂O) $_{10}$ CH (CH₃) (CH₂) $_{2}$ C₈F₁₇, C₆F₁₃ (CH₂) $_{2}$ CH (CH $_{3})0(C_{3}H_{6}0)_{5}(CH_{2}CH_{2}0)_{10}CH(CH_{3})(CH_{2})_{2}C_{6}F_{13}$, $C_{6}F$ $_{15}(CH_2)_2CH(CH_3)0(C_3H_60)_5(CH_2CH_20)_{10}CH(CH_3)(CH_2)_2C_6$ F_{15} , $C_8F_{17}(CH_2)_2CH(CH_3)O(C_3H_6O)_5(CH_2CH_2O)_{10}CH(CH_3)O(C_3H_6O)_5$ $_{3}$) (CH₂)₂C₈F₁₇, C₆F₁₃(CH₂)₂CH(CH₃)0(C₃H₆0)₄(CH₂CH 20)₁₅CH(CH₃)(CH₂)₂C₆F₁₃ 、C₇F₁₅(CH₂)₂CH(CH₃)0(C₃H 50 も、また、それぞれの構成成分を混合してフォトレジス

80) 4 (CH₂CH₂O) 15CH (CH₃) (CH₂) 2C₇F₁₅, C₈F₁₇ (CH₂) 2CH (C H_3) $0(C_3H_60)_4(CH_2CH_20)_{15}CH(CH_3)(CH_2)_2C_8F_{170}$

【0052】特定の含フッ素化合物は2種以上使用して もよい。2種以上である場合には、k値の異なる特定の 含フッ素化合物を2種以上、および/または、R「基の 炭素数の異なる特定の含フッ素化合物を2種以上使用す るのが好ましい。特定の含フッ素化合物の使用量は、そ の構造やフォトレジスト組成物の種類に応じ適宜選定さ れるが、フォトレジスト組成物に対して下限としては1 Oppmが好ましく、特に好ましくは20ppmであ り、50ppmがさらに好ましく、上限としては200 Oppmが好ましく、特に好ましくは1000ppmで ある。添加量が多すぎると好ましい低起泡性が発現しな いおそれがあり、少なすぎると塗布ムラが発生するおそ れがある。

【0053】本発明のフォトレジスト組成物中には、必 要に応じて上記以外の成分(以下、他の成分と記載す る。)が含まれていてもよい。他の成分としては、上記 以外のフッ素系界面活性剤、非フッ素系界面活性剤等が 挙げられる。該フッ素系界面活性剤または非フッ素系界 面活性剤としては、非イオン性、アニオン性およびカチ オン性から選ばれる少なくとも1種の極性基を有する界 面活性剤が採用できる。またジメチルポリシロキサン鎖 を有する界面活性剤でもよく、また不飽和単量体を重合 させてなる高分子量のフッ素系界面活性剤であってもよ い。他の成分の量は本発明の効果を損ねない範囲であれ ば、特に限定されない。

【0054】本発明のフォトレジスト組成物を製造する 場合には、あらかじめ調製したフォトレジスト原液に本 発明の特定の特定の含フッ素化合物を添加してもまた、 アルカリ可溶性樹脂、キノンジアジド系感光性化合物等 の固型成分を有機溶媒に溶解する際に添加してもよい。 また、IC製造においては、使用する材料は微量金属に 代表される不純物を極力少なくするのが好ましく、フォ トレジスト組成物についても純度の向上のために、それ ぞれの構成成分をそれぞれイオン交換法等により精製を 行ってから混合してフォトレジスト組成物を製造して

ト液を製造してからイオン交換法等により精製を行って もよい。また、本発明のフォトレジスト組成物を集積回 路の製造に使用する場合には、サブミクロンのポアのフィルタにより濾過してから使用するのが好ましい。

[0055]

【実施例】つぎに、実施例を挙げて本発明をさらに詳し く説明する。

[例1~3 (実施例)、例4 (比較例)] フォトレジスト組成物の調製例

[0056]

【化5】含フッ素化合物(イ):C₈F₁₃(CH₂)₂CH(CH₃)0(CH₂CH₂O)₈H、

含フッ素化合物 (ロ) : C₆F₁₃(CH₂)₂CH(CH₃)0(CH₂CH₂0)₅CH₃、

含フッ素化合物 (ハ) : C₆F₁₃(CH₂)₂CH(CH₃)0(CH₂CH₂0)₅CH(CH₃)(CH₂)₂C₆F₁₃、

比較化合物(二):炭素数9のパーフルオロアルキル基を有するアクリレート、ポリエチレングリコールモノメタクリレート、ポリプロピレングリコールモノメタクレートとの共重合体。

[0057]

【表1】

例	含フッ素化合物	添加量(ppm)		
1 (実施例)	(イ)	8 0		
2 (実施例)	(ロ)	8 0		
3 (実施例)	(ハ)	8 0		
4 (比較例)	(二)	2 5 0		

【0058】 [フォトレジスト組成物の評価例] 例1~

4で得たフォトレジスト組成物を次のような項目について評価を行った。結果を表2にまとめて示す。

14

(1) 塗布ムラの評価

それぞれのフォトレジスト組成物 2m1を直径 5インチのシリコンウエハに滴下し、スピンコート法により塗布した後、ホットプレート上にて70秒間加熱して溶媒を除去し、膜厚 1. 5 μ m のフォトレジスト塗布膜を形成した。この塗布膜の表面を光学顕微鏡によって観察し、筋状の塗布ムラの発生状態を調べた。

0 【0059】(2)消泡性

それぞれのフォトレジスト組成物20mlを50mlのサンプル管に入れこれらのサンプル管を20回激しく振り混ぜた。その後静置して、発生した泡が消えるまでの時間を計測した。それぞれのフォトレジスト組成物1.5mlを直径5インチのシリコンウエハに滴下し、スピンコート法により塗布した後、ホットプレート上にて70秒間加熱して溶媒を除去し、膜厚1.5μmのフォトレジスト塗布膜を形成した。この塗布膜を目視観察し塗れ残りの有無を調べた。

20 【0060】(3)解像力の評価

それぞれのフォトレジスト組成物 2m1 を直径 5 インチのシリコンウエハに滴下し、スピンコート法により塗布した後、80 \mathbb{C} ホットプレート上にて70 秒間加熱して溶媒を除去し、膜厚 2 . 0 μ のフォトレジスト塗布膜を形成した。このものを、(株)ニコン製 i 線ステッパ(NA. = 0.50)にて露光した後、110 \mathbb{C} ホットプレート上にて70 秒間加熱し、次に 2 . 38 %水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液に60 秒間浸し、現像した。形成されたパターンの断面形状を電子顕微鏡により観察し、解像力(0 . 6 μ mの線帽/線間隔のパターンが 1 : 1 に仕上がる露光量にて、分離解像される線幅/線間隔パターンの最小パターンサイズ、単位: μ m)を評価した。

【0061】(4)組成物の安定性の評価

それぞれのフォトレジスト組成物20mlを50mlの サンプル管に入れこれらのサンプル管を35℃の水浴中 で24時間、振動させた。24時間後のサンプル管を1 時間静置し、沈殿物の有無を目視で判断した。

【0062】(5) 充填時間の比較

40 フォトレジスト組成物をフォトレジスト用容器に充填する際の時間を測定し、例4の組成物に対する時間(倍)を求めた。

【0063】 【表2】

30

15

	塗布ムラ	消泡性	解像力	安定性	充填速度
例1	なし	25分	0.4	沈殿無	0. 7
例 2	なし	20分	0.4	沈殿無	0.6
例3	なし	15分	0.35	沈殿無	0.5
例4	なし	120 分以上	測定せず	沈殿有	1

[0064]

リエーションのような塗布ムラは発生せず、レジスト液 中に発生した泡がレジスト液による塗布膜の形成を阻害 することなく、さらに塗れ残りもない優れた組成物であ*

*る。また、特定の含フッ素化合物は、それ自体が化学的 【発明の効果】本発明のフォトレジスト組成物は、スト 10 安定性に優れ、また、フォトレジスト原液中に含まれる 成分に悪影響を与えるおそれがない化合物であることか ら、組成物の安定性にも寄与する優れた化合物である。

16

フロントページの続き

(72)発明者 髙田 真季

東京都千代田区丸の内二丁目1番2号 旭 硝子株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA00 AB16 BE01 CB17 CB29 CB52 CC03 CC04